



2024年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2023年7月11日

上場会社名 ローツェ株式会社 上場取引所 東
コード番号 6323 URL <https://www.rorze.com>
代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 藤代 祥之
問合せ先責任者 (役職名) 管理部長 (氏名) 伊勢村 英一 (TEL) 084-960-0001
四半期報告書提出予定日 2023年7月14日 配当支払開始予定日 -
四半期決算補足説明資料作成の有無：有
四半期決算説明会開催の有無：無

(百万円未満切捨て)

1. 2024年2月期第1四半期の連結業績（2023年3月1日～2023年5月31日）

(1) 連結経営成績（累計）

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年2月期第1四半期	16,693	△23.0	4,718	△6.2	5,208	△27.5	3,557	△30.6
2023年2月期第1四半期	21,688	50.2	5,029	76.6	7,186	103.0	5,126	90.1

(注) 包括利益 2024年2月期第1四半期 3,867百万円 (△46.1%) 2023年2月期第1四半期 7,175百万円 (77.9%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2024年2月期第1四半期	201 91	201 54
2023年2月期第1四半期	296 64	296 08

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2024年2月期第1四半期	140,392	80,099	52.4
2023年2月期	126,482	74,795	53.9

(参考) 自己資本 2024年2月期第1四半期 73,564百万円 2023年2月期 68,222百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2023年2月期	-	0 00	-	135 00	135 00
2024年2月期	-	-	-	-	-
2024年2月期（予想）	-	0 00	-	135 00	135 00

(注) 直前に公表されている配当予想からの修正の有無：無

3. 2024年2月期の連結業績予想（2023年3月1日～2024年2月29日）

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期（累計）	43,127	△5.7	10,673	△2.4	10,643	△37.0	7,633	△38.3	433 29
通期	88,026	△6.9	21,619	△18.2	21,553	△29.0	15,718	△26.5	892 13

(注) 直前に公表されている業績予想からの修正の有無：無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動：無
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 一社 (社名) 、除外 一社 (社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数 (普通株式)

① 期末発行済株式数 (自己株式を含む)	2024年2月期1Q	17,640,000株	2023年2月期	17,640,000株
② 期末自己株式数	2024年2月期1Q	19,791株	2023年2月期	358,747株
③ 期中平均株式数 (四半期累計)	2024年2月期1Q	17,616,538株	2023年2月期1Q	17,281,305株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述について)

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料2ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
四半期連結損益計算書	5
四半期連結包括利益計算書	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
(セグメント情報等)	7
(企業結合等関係)	8
3. 補足情報	9
生産、受注及び販売の状況	9

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、緩やかに持ち直しの動きが見られましたが、世界的なインフレ圧力に伴う各国中央銀行の金融引締め、米中半導体輸出規制の強化による影響等、依然として先行きが不透明な状況が継続しております。

当業界におきましては、中長期的には生成系AI、5G、IoTなどの情報通信技術の発展や、それに伴うデータセンターの能力拡張等、半導体市場の力強い成長が見込まれており、世界各地域では政府支援も背景とした半導体関連の工場建設の計画が進んでおります。一方、短期的にはメモリ半導体の世界的な半導体需要の減速に伴い、半導体メーカーによる在庫調整や設備投資の先送りの動きが見られました。

このような環境のもと、当社グループにおきましては、顧客動向を注視しながら受注状況等を確認し、受注量の増減に対応できるように生産システムの強化に取り組んでまいりました。

一方、コロナ禍以降急増した半導体需要の反動減により、半導体メーカー各社が一時的な在庫調整局面に入った影響を受け、半導体関連装置の売上は減少しました。

この結果、当第1四半期連結累計期間の経営成績は、売上高16,693百万円（前年同期比23.0%減）、営業利益4,718百万円（前年同期比6.2%減）、経常利益5,208百万円（前年同期比27.5%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益3,557百万円（前年同期比30.6%減）となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

半導体・FPD関連装置事業の売上高は16,592百万円（前年同期比23.3%減）、セグメント利益は4,898百万円（前年同期比5.9%減）となりました。

ライフサイエンス事業の売上高は100百万円（前年同期比123.5%増）、セグメント損失は62百万円（前年同期はセグメント損失76百万円）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産の状況

当第1四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末に比べ13,909百万円増加し、140,392百万円となりました。これは主に、棚卸資産の増加9,256百万円及び現金及び預金の増加4,963百万円によるものであります。

負債は、前連結会計年度末に比べ8,606百万円増加し、60,293百万円となりました。これは主に、借入金の増加8,189百万円によるものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べ5,303百万円増加し、80,099百万円となりました。これは主に、資本剰余金の増加3,761百万円及び利益剰余金の増加1,224百万円によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2024年2月期の第2四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、2023年4月11日発表の「2023年2月期決算短信〔日本基準〕（連結）」に記載しております予想数値から変更はありません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年2月28日)	当第1四半期連結会計期間 (2023年5月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	28,292	33,255
受取手形及び売掛金	26,722	20,986
商品及び製品	2,778	5,115
仕掛品	14,067	17,074
原材料及び貯蔵品	25,988	29,901
その他	2,150	2,395
貸倒引当金	△12	△24
流動資産合計	99,986	108,704
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	10,398	10,803
機械装置及び運搬具（純額）	6,209	6,033
土地	4,415	4,548
その他（純額）	1,079	869
有形固定資産合計	22,102	22,255
無形固定資産		
のれん	-	4,813
その他	643	623
無形固定資産合計	643	5,437
投資その他の資産		
投資有価証券	1,369	1,412
退職給付に係る資産	189	162
繰延税金資産	1,290	1,331
その他	954	1,142
貸倒引当金	△53	△53
投資その他の資産合計	3,749	3,996
固定資産合計	26,496	31,688
資産合計	126,482	140,392

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年2月28日)	当第1四半期連結会計期間 (2023年5月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	7,350	7,734
短期借入金	14,936	16,435
未払法人税等	4,268	2,201
賞与引当金	1,021	1,019
役員賞与引当金	72	1
製品保証引当金	1,287	1,106
その他	4,107	6,096
流動負債合計	33,044	34,595
固定負債		
長期借入金	17,887	24,578
役員退職慰労引当金	306	406
退職給付に係る負債	67	65
資産除去債務	272	276
繰延税金負債	105	191
その他	3	178
固定負債合計	18,643	25,698
負債合計	51,687	60,293
純資産の部		
株主資本		
資本金	982	982
資本剰余金	1,470	5,231
利益剰余金	61,221	62,445
自己株式	△55	△3
株主資本合計	63,619	68,657
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	153	169
為替換算調整勘定	4,449	4,737
その他の包括利益累計額合計	4,602	4,907
新株予約権	85	85
非支配株主持分	6,487	6,449
純資産合計	74,795	80,099
負債純資産合計	126,482	140,392

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 (四半期連結損益計算書)
 (第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年5月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年5月31日)
売上高	21,688	16,693
売上原価	14,956	9,749
売上総利益	6,731	6,943
販売費及び一般管理費	1,702	2,225
営業利益	5,029	4,718
営業外収益		
受取利息	2	2
為替差益	2,118	526
売電収入	18	15
デリバティブ利益	13	-
その他	23	81
営業外収益合計	2,177	626
営業外費用		
支払利息	11	18
売電費用	5	4
デリバティブ損失	-	101
その他	3	11
営業外費用合計	20	136
経常利益	7,186	5,208
特別利益		
固定資産売却益	0	2
特別利益合計	0	2
特別損失		
固定資産売却損	-	0
固定資産除却損	4	0
特別損失合計	4	0
税金等調整前四半期純利益	7,181	5,210
法人税、住民税及び事業税	1,836	1,470
法人税等調整額	△96	37
法人税等合計	1,740	1,507
四半期純利益	5,441	3,702
非支配株主に帰属する四半期純利益	315	145
親会社株主に帰属する四半期純利益	5,126	3,557

(四半期連結包括利益計算書)
(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年5月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年5月31日)
四半期純利益	5,441	3,702
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△6	15
為替換算調整勘定	1,740	148
その他の包括利益合計	1,734	164
四半期包括利益	7,175	3,867
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	6,660	3,861
非支配株主に係る四半期包括利益	515	5

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

当社は、2023年1月6日開催の取締役会決議に基づき、2023年3月2日付で、当社を株式交換完全親会社、株式会社イアスを株式交換完全子会社とする株式交換による自己株式338,976株の処分を行っております。この結果、当第1四半期連結累計期間において資本剰余金が3,761百万円増加し、自己株式が52百万円減少し、当第1四半期連結会計期間末において資本剰余金が5,231百万円、自己株式が3百万円となっております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当第1四半期連結累計期間(自 2023年3月1日 至 2023年5月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位:百万円)

	報告セグメント			調整額 (注)1	四半期 連結財務諸表 計上額 (注)2
	半導体・FPD 関連装置事業	ライフ サイエンス 事業	計		
売上高					
日本	2,642	47	2,690	—	2,690
台湾	2,843	—	2,843	—	2,843
中国	3,667	53	3,721	—	3,721
韓国	1,189	—	1,189	—	1,189
米国	4,581	0	4,581	—	4,581
その他	1,666	—	1,666	—	1,666
顧客との契約から生じ る収益	16,592	100	16,693	—	16,693
外部顧客への売上高	16,592	100	16,693	—	16,693
セグメント間の内部売 上高又は振替高	2	—	2	△2	—
計	16,595	100	16,696	△2	16,693
セグメント利益 又は損失(△)	4,898	△62	4,836	△118	4,718

(注)1. セグメント利益又は損失の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用△118百万円であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(のれんの金額の重要な変動)

半導体・FPD関連装置事業セグメントにおいて、第1四半期連結会計期間に、株式会社イアスの全株式を取得し、連結の範囲に含めたことにより、のれんが発生しております。なお、当該事象によるのれんの発生額は、当第1四半期連結累計期間においては4,937百万円ですが、当該のれんの金額は取得原価の配分が完了していないため、暫定的に算定された金額であります。

(企業結合等関係)

取得による企業結合

1. 企業結合の概要

(1) 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称：株式会社イアス

事業の内容：ICP-MS等の部品・周辺機器及び金属分析前処理装置の製造・販売

(2) 企業結合を行った主な理由

株式会社イアスは、経験に裏打ちされた確かな技術をベースにICP-MS(誘導結合プラズマ質量分析)を用いた微量元素分析に求められるソリューションを提供しています。主力製品Expertシリーズは、シリコンウエハ表層部の金属不純物の分析において、高水準の自動化とともに、業界最高水準の検出精度を達成する装置であり、数多くの最先端半導体工場にて既に導入されています。

当該企業結合は、技術による製品開発を最重視するという類似した企業文化を有する両社にて、最先端の半導体製造工程における微細化進行に対応し、異物混入による半導体製造の歩留り低下を防止することの重要性が高まる中で、共通の目的に向かって技術的な融合及び次世代製品の開発を実現していくものです。さらに、同社の製品を当社のグローバルな製品供給体制で支援することによって、品質の信頼性向上とともにさらに高い顧客満足度を獲得し、成長を加速することが可能となり、当社グループ全体としての今後の成長に寄与することが期待されます。

(3) 企業結合日

株式取得日：2023年3月1日

株式交換日：2023年3月2日

(4) 企業結合の法的形式

当社を完全親会社とし、株式会社イアスを完全子会社とする株式取得及び株式交換

(5) 結合後企業の名称

変更ありません。

(6) 取得議決権比率

企業結合直前に所有していた議決権比率	-%
現金対価により取得した議決権比率	52.0%
株式交換により追加取得した議決権比率	48.0%
取得後の議決権比率	100.0%

(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金及び自己株式を対価として株式を取得したことによるものであります。

2. 四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間

2023年3月1日から2023年5月31日まで

3. 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価	現金	2,964百万円
取得の対価	自己株式	3,813百万円
取得原価		6,778百万円

4. 本株式交換に係る割当の内容

主体	当社 (株式交換完全親会社)	株式会社イアス (株式交換完全子会社)
株式交換に係る割当の内容	1	396
株式交換により交付した株式数	当社普通株式：338,976株	

(注) 1. 当社は、公平性・妥当性を確保するため、独立した第三者算定機関として算定機関を選定し、株式交換比率の算定を依頼いたしました。

2. 本株式交換により交付した当社株式は、全て当社が保有する自己株式を充当しております。

5. 主要な取得関連費用の内容及び金額

アドバイザー費用等 21百万円

6. 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

(1) 発生したのれんの金額

4,937百万円

なお、上記の金額は、暫定的に算定された金額です。

(2) 発生原因

今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力であります。

(3) 償却方法及び償却期間

10年間にわたる均等償却

3. 補足情報

生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

当第1四半期連結累計期間における生産実績をセグメントごと及び品目別に示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	品目	生産高 (百万円)	前年同期比 (%)
	F P D関連装置	261	13.8
	モータ制御機器	24	102.3
	計	9,379	63.5
ライフサイエンス事業		45	128.1
合計		9,425	63.6

(注) 1. 金額は、製造原価によっております。

(2) 受注実績

当第1四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごと及び品目別に示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	品目	受注高 (百万円)	前年同期比 (%)	受注残高 (百万円)	前年同期比 (%)
	分析装置	820	—	4,793	—
	F P D関連装置	1,059	119.6	1,418	53.0
	計	15,485	56.3	61,698	105.1
ライフサイエンス事業		377	122.1	600	119.4
合計		15,863	57.1	62,298	105.2

(注) 1. 金額は、販売価格によっております。

(3) 販売実績

当第1四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごと及び品目別に示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 品目	販売高（百万円）	前年同期比（%）
半導体関連装置	13,987	76.8
分析装置	715	—
FPD関連装置	346	16.0
モータ制御機器	49	136.9
部品・修理 他	1,493	121.5
計	16,592	76.7
ライフサイエンス事業	100	223.5
合計	16,693	77.0

(注) 1. 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先	前第1四半期連結累計期間		当第1四半期連結累計期間	
	販売高 (百万円)	割合（%）	販売高 (百万円)	割合（%）
Applied Materials, Inc.	4,173	19.2	3,934	23.6
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd.	2,415	11.1	—	—

(注) 1. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd. に対する当第1四半期連結累計期間の売上高は、1,545百万円（総販売実績に対する割合9.3%）であります。